



tesa HAF® 8410 HS



Tuote Tiedot

Lämpöaktivoituva kalvo sirun kiinnittämiseksi älykorttiin

Tuotteen kuvaus

tesa® HAF 8410 HS on kaksipuolinen lämpöaktivoitava liimakalvo. Se koostuu fenolihartsista ja nitrilikumista.

Käyttökohteet

tesa® HAF 8410 HS on tarkoitettu sirujen kiinnittämiseen älykortteihin turvallisesti. Se kestää pitkään.

- Soveltuu PVC-, ABS-, PET- ja PC-kortteihin
- Toimii hyvin kaikilla yleisillä kiinnityslinjoilla
- Kestää ikääntymistä
- Säilyttää joustavuutensa koko käyttöikänsä ajan, sillä sisältää runsaasti kumia

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | ei ole | • Kokonaispaksuus | 60 µm |
| • Liimatyyppi | nitrilikumi /
fenoliharts | • Väri | amber |
| • Suojamateriaalityyppi | silikonipaperi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| • Bonding strength (dynamic shear) | 12 N/mm ² | • Bonding strength (push-out) | 12 N/mm ² |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|

Lisätiedot

Tekniset suositukset älykorttisovelluksille:

Seuraavat arvot ovat suosituksia aloitusparametreiksi. Huomaa, että ihanteelliset parametrit vaihtelevat koneen tyyppin, korttien ja sirumoduulien materiaalien ja asiakkaan vaatimusten mukaan.

1. Esilaminointi:

Esilaminoinnin aikana teippi laminoidaan moduuliin. Tämä vaihe voidaan tehdä tuotannon aikana tai erikseen.

Esilaminointivaihe ei vaikuta teipin säilyvyyteen. Esilaminoidut moduulit voidaan säilyttää yhtä pitkään kuin teippi.

Koneen asetukset:

- Lämpötila 120 – 140 °C
- Paine 4 - 6 baaria
- Aika 1,5 – 3,0 sek

2. Moduulin kiinnittäminen:

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=08410>



tesa HAF® 8410 HS

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Kun moduuli kiinnitetään esilaminoidut moduulit stanssataan irti, asetetaan kortin aukkoon ja kiinnitetään paikalleen pysyvästi kuumentamalla. Tarkka menetelmä määräytyy sen mukaan, millaista tuotantolinjaa käytetään. Seuraavat ovat kaksi yleisintä menetelmää:

Yksivaiheinen prosessi, koneen asetukset (alhainen lämpötila):

- Lämpötila¹ 160 – 180 °C
- Paine 65 N/moduuli
- Aika 2,0 – 4,0 sek

Yksivaiheinen prosessi, koneen asetukset (korkea lämpötila):

- Lämpötila¹ 180 – 200 °C
- Paine 65 N/moduuli
- Aika 1,0 – 1,5 sek

Monivaiheinen prosessi (vähintään 2 lämmityspainallusta), koneen asetukset :

- Lämpötila¹ 170 – 200 °C
- Paine 65 N/moduuli
- Aika (kussakin vaiheessa) 0,7 - 1,2 sek

¹Lämpötila mitattuna painallusvaiheen aikana

Muissa kuin toimikorttisovelluksissa on käytettävä erilaisia koneen parametrejä. Varastointiaika määräytyy tesa® HAF - käyttökohteen mukaan.

Huomautus: Sidoksen vahvuusarvot on saavutettu vakioiduissa laboratorio-olosuhteissa (keskiarvot). Kunkin valmistuserän arvojen taataan asettuvan tietylle alueelle (materiaali: etsattu alumiininäyte, liimaolosuhteet: lämpötila 120 °C; paine 10 baaria, aika 8 min).

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=08410>